

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2024年6月18日)

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>专场机构交流会 <input type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他 _____</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>财通证券 王雨然、彬元资本 陈海亮、Eastspring 许晓骅、富兰克林华美 苏士勋、UG Fund Wade Lin 林全朗、Nikko Truman、Hangseng Andrew Tong、Aspoon 沈宇峰、JoinAsset Oh SungJin、JoinAsset Jang Jisung、harmolands 马腾、Capstone Capital 余华莘、红杉资本 Edward Cao、韩国投资 蒋颖、TT International Sharon Tsoi、路博迈 王舒磊、立格（盖茨基金） 李学来、海通证券 王海涛、海通证券 石佳佳、海通证券 张晓飞、海通证券 郇奕滢、海通证券 李轩</p>
<p>会议时间</p>	<p>2024年6月18日 09:30-10:30、14:00-15:00、16:00-17:00</p>
<p>会议地点</p>	<p>佰维存储三楼会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>公司管理层 董办工作人员</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>Q1. 公司对于存储行业下半年市场趋势有何判断？ A1: 据 TrendForce 集邦咨询最新预估，第二季 DRAM 合约价季涨幅将上修至 13%-18%；NAND Flash 合约价季涨幅同步上修至约 15%-20%。随着存储市场将在第三季度进入传统旺季，受益于 AI 服务器需求迅猛增长、HBM 需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，海外存储需求持续高涨，国内需求有所回落，但整体来看行业景气度有望延续。</p> <p>Q2. 公司在企业级存储领域有哪些布局？如何进一步突破企业级存储客户？ A2: 公司企业级存储可分为 SATA SSD、PCIe SSD、CXL 内存、RDIMM 内存条四大类产品，主要应用于数据中心、通用服务器、AI/ML 服务器、云计算、大数据等场景。企业级市场壁垒较高、发展前景广阔，公司将进一步完善产品布局，紧抓国产化机遇，实现业务突破。</p> <p>Q3. 晶圆价格与公司毛利率水平存在什么关系？ A3: 公司核心原材料为 NAND Flash 晶圆和 DRAM 晶圆，存储晶圆的采购价格变动对公司的成本结构具有较大影响。通常来说，上游存储晶圆市场价格上行，存储器的市场价格也会同向波动。公司毛利率水平受供需关系、市场竞争等多种因素决定。公司存货采用移动加权平均法，一定程度上能平滑毛利率受成本波动的影响。</p> <p>Q4. AIPC 产品落地对公司有哪些方面的影响？</p>

	<p>A4: AIPC 方面, Canalsys 预计 2024 年全球 AIPC 出货量将达到 4,800 万台, 占 PC 总出货量的 18%。AIPC 基于大模型的算力需求, 对搭载大容量先进制程 DRAM 产品的需求增加, 同时为了有效管理 PC 上运行的 AI 数据, 也会增加对 NAND 产品的需求。在 DRAM 方面, 由于更轻薄、长续航以及 LPCAMM 新形态产品在 PC 上的应用发展, 预计 LPDDR, 尤其是 LPDDR5/5X 将迎来迅速发展。公司将持续推出适用于 PC 应用的 PCIe3.0/4.0/5.0 SSD、LPDDR4X/5/5X 等产品, 以满足客户对于 AIPC 存储产品的需求。</p> <p>Q5. 公司的备货策略及库存水平如何? A5: 公司采取按需采购的备货策略, 根据与下游客户签立的销售订单及自身库存情况向供应商提出采购需求。2024 年第一季度, 公司存货水平为 34.61 亿元。</p> <p>Q6. 公司在智能穿戴领域有哪些布局? A6: 公司在智能穿戴领域推出了 ePOP、eMCP 系列产品, 该系列产品具备小尺寸、低功耗、高可靠、高性能等优势。在智能穿戴领域, 公司产品已进入 Google、小米、Meta、小天才等国际知名智能穿戴厂商; 其中, 公司为 Meta 最新款 AI 智能眼镜 Ray-Ban Meta 提供 ROM+RAM 存储器芯片。</p> <p>Q7. 公司在先进封测领域有哪些技术及优势? A7: 公司已掌握 16 层叠 Die、30~40 μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进封装工艺, 为 NAND Flash 芯片、DRAM 芯片和 SiP 封装芯片的大规模量产提供支持, 使得存储芯片在体积、散热、电磁兼容性、可靠性、存储容量等方面拥有较强的市场竞争力。此外, 公司拟定增资建设的晶圆级先进封测项目专注于高性能计算、先进智能终端、物联网等领域的高端封装需求, 涵盖 WLCSP、2.5D/3D 等晶圆级先进封装技术。目前公司具有存储芯片和逻辑芯片整合封装、测试研发能力, 构建了完整的、国际化的专业晶圆级先进封装技术和团队, 具备成熟研发和量产经验。晶圆级先进封测产线与现有公司供应链有相当的重合度, 可以有效利用供应链资源降低制造和采购成本。</p> <p>Q8. 公司产品已进入哪些国内外客户? A8: 公司产品在国内存储厂商中市场份额位居前列, 并已进入各细分领域国内外一线客户供应体系。在手机领域, 公司嵌入式存储产品进入 OPPO、传音控股、摩托罗拉、HMD、ZTE、TCL 等知名客户; 在 PC 领域, 公司 SSD 产品目前已经进入联想、Acer、HP、同方等国内外知名 PC 厂商; 在国产 PC 领域, 公司是 SSD 产品的主力供应商, 占据优势份额; 在智能穿戴领域, 公司产品已进入 Google、小米、Meta、小天才等国际知名智能穿戴厂商; 在车规领域, 公司产品正在导入国内头部车企及 Tier1 客户。</p> <p>Q9: 公司在主控芯片设计方面有什么进展? A9: 公司推出的第一颗主控芯片性能优异, 产品目前已回片验证, 进行量产准备。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 6 月 18 日</p>

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。
-----------	--